

---

# 南亞電路板股份有限公司 2018年營運概況

2019年3月28日



## 免責聲明

---

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



# 議程

---

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 未來營運目標



# 公司概況

## 事業簡述

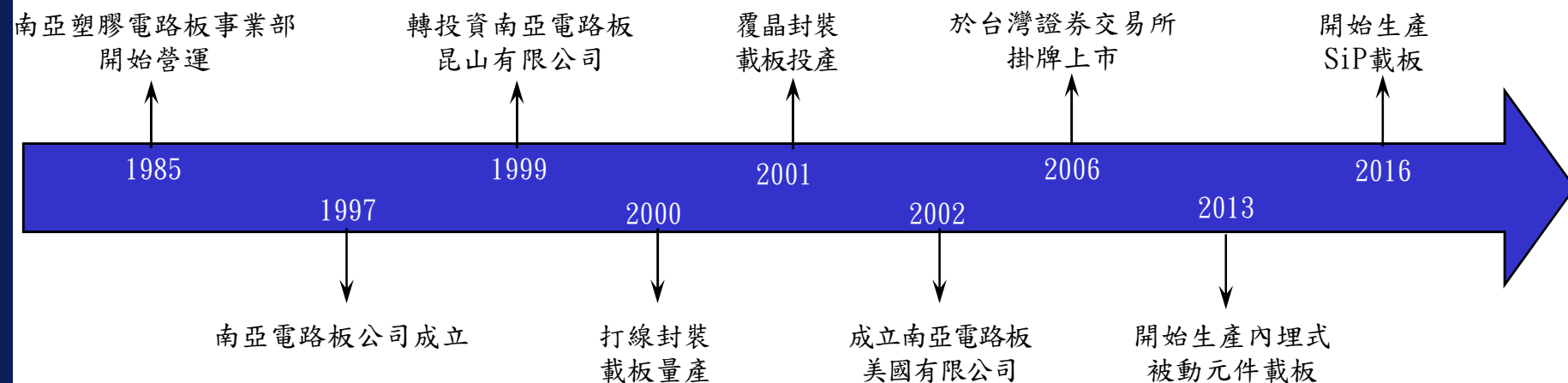
---

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售一般電路板與IC載板
- 2018年合併營業額為新台幣 288.3億元。
- 台股上市市值：新台幣218.4億元(2018年12月28日)
- 生產廠區：台灣、大陸



# 公司概況

## 歷史沿革



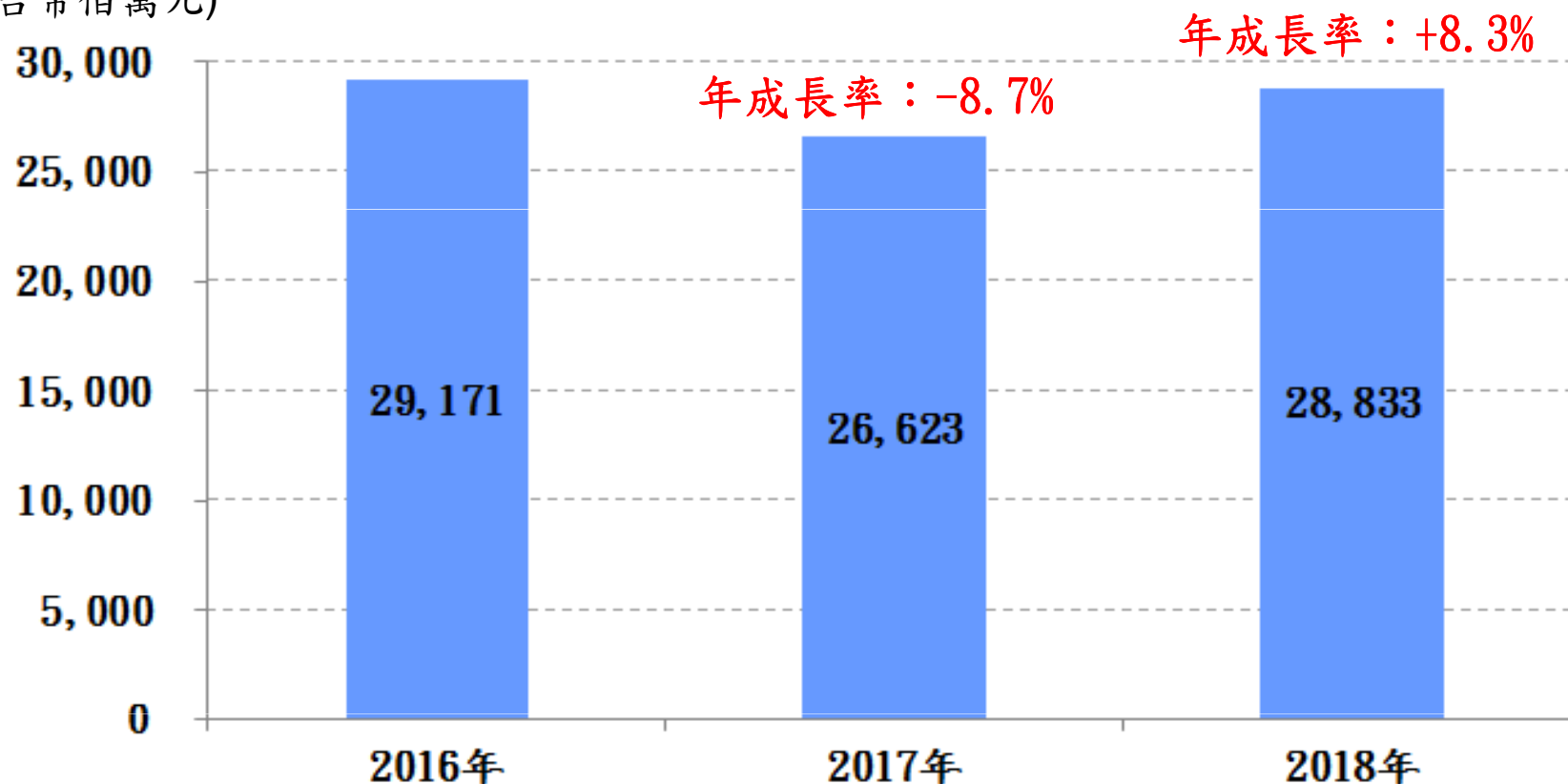
- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)



# 財務狀況

## 近三年合併營業收入(IFRS)

(新台幣佰萬元)



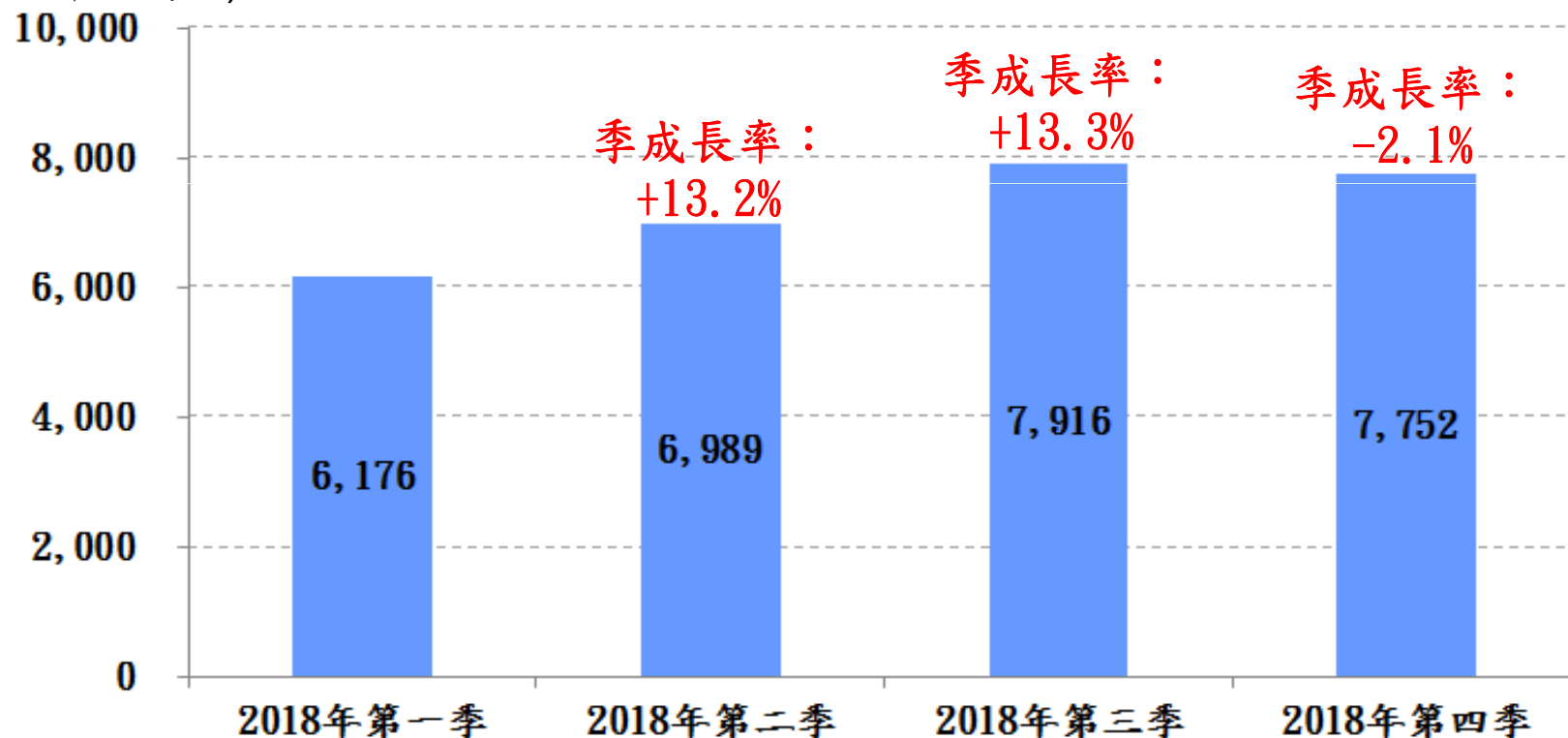
- 2017年營收較2016年減少8.7%：  
受電腦產品銷售不佳影響，本公司於2017年策略性調整產品結構，致2017年比2016年營業額減少。
- 2018營收較2017年增加8.3%：  
本公司致力於拓展高值化產品市場，提升產品平均售價，故2018年營收比2017年成長。



# 財務狀況

## 2018年每季合併營業收入(IFRS)

(新台幣佰萬元)



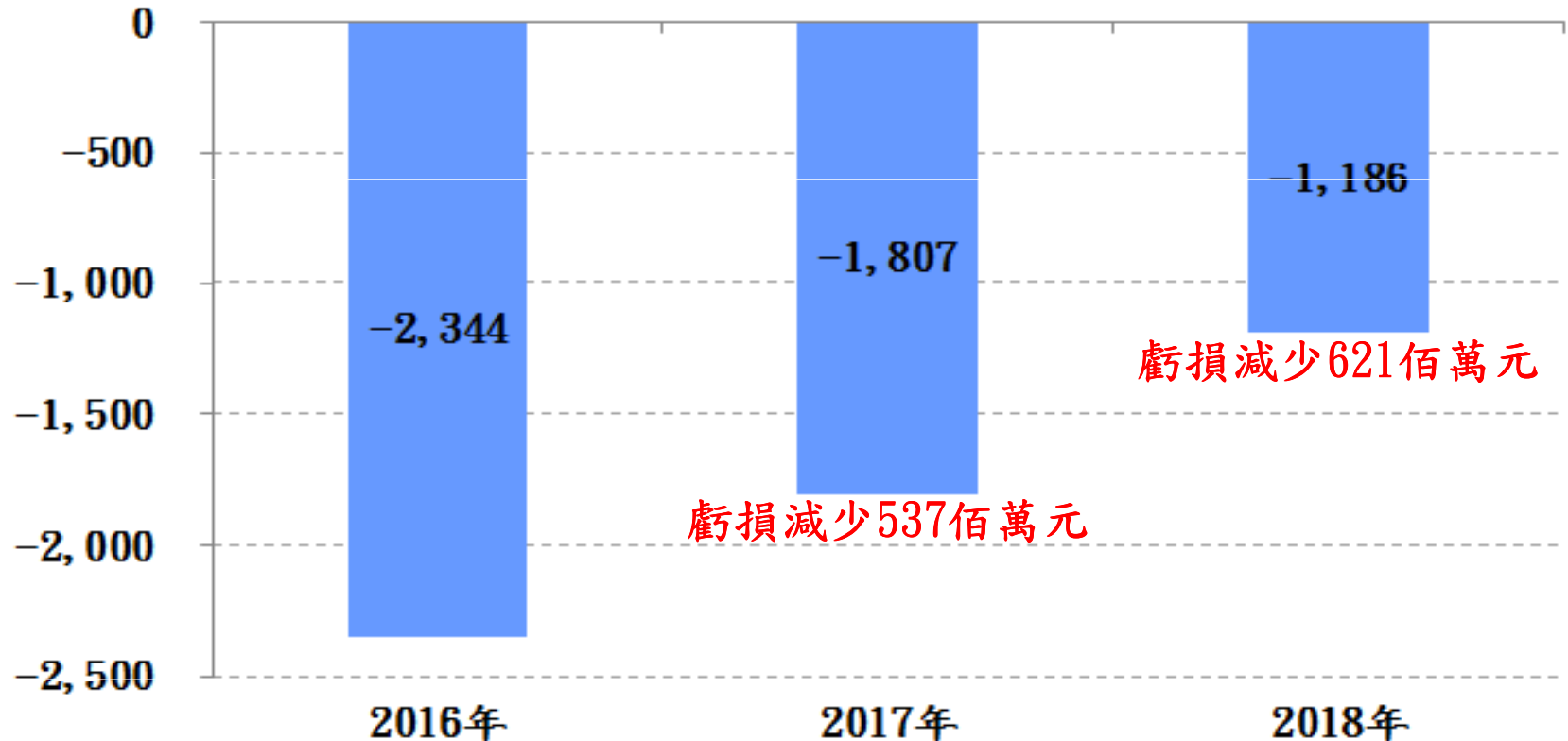
- 2018年第二季營收較第一季增加13.2%：  
2018年第二季逐漸擺脫電子產品銷售淡季影響，營收比第一季成長。
- 2018年第三季營收較第二季增加13.3%：  
2018年第三季因系統級封裝(SiP)與ABF載板需求提升，故第三季營收持續成長。
- 2018年第四季營收較第三季減少2.1%：  
2018年第四季因消費性與車用電子進入銷售淡季，故第四季營收下滑。



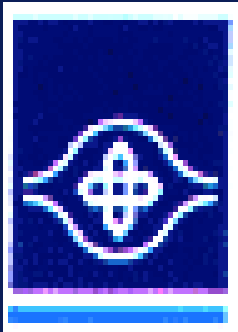
# 財務狀況

## 近三年營業利益(虧損)

(新台幣佰萬元)



- 2017年營業虧損較2016年減少537佰萬元：  
因策略性減少虧損嚴重之個人電腦應用載板接單，故2017年營業虧損比2016年減少。
- 2018年營業虧損較2017年減少621佰萬元：  
本公司2018年致力於提升高值化產品銷售比重，改善產品組合，使2018年營業虧損比2017年減少。

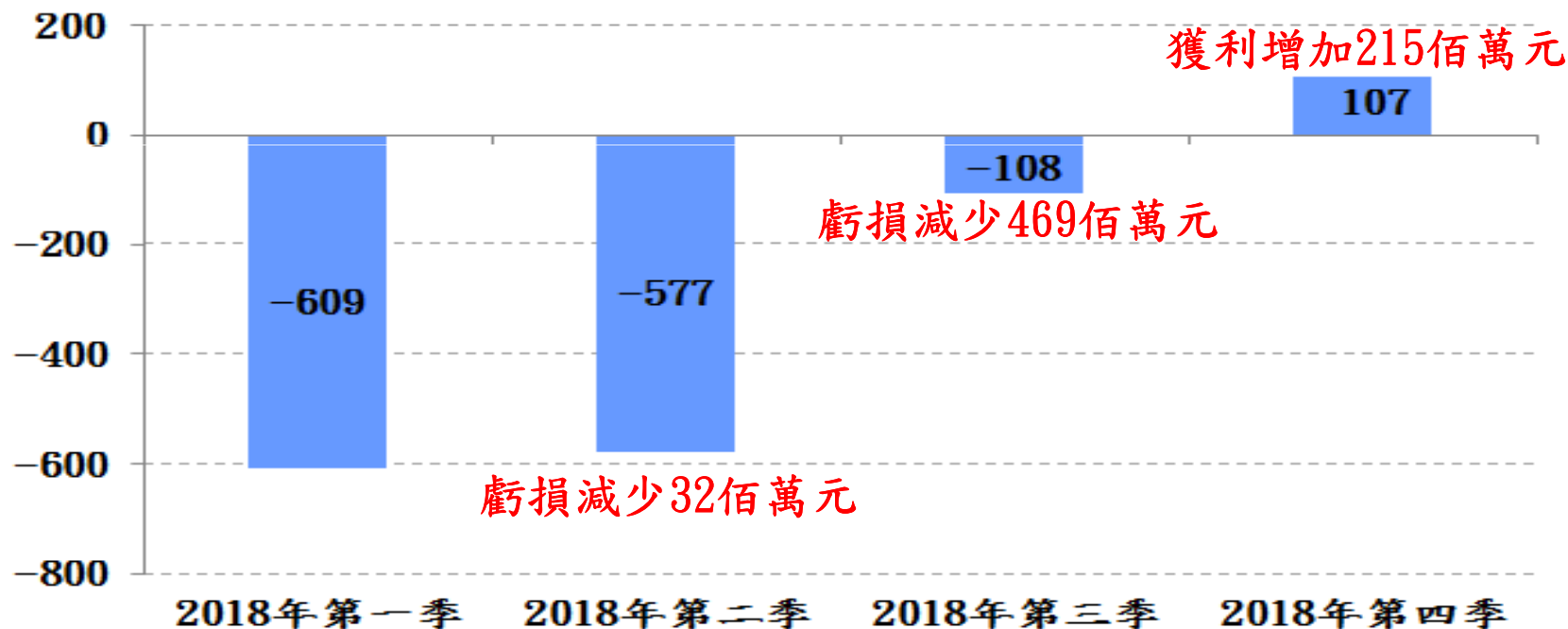




# 財務狀況

## 2018年每季營業利益(虧損)

(新台幣佰萬元)  
營業利益

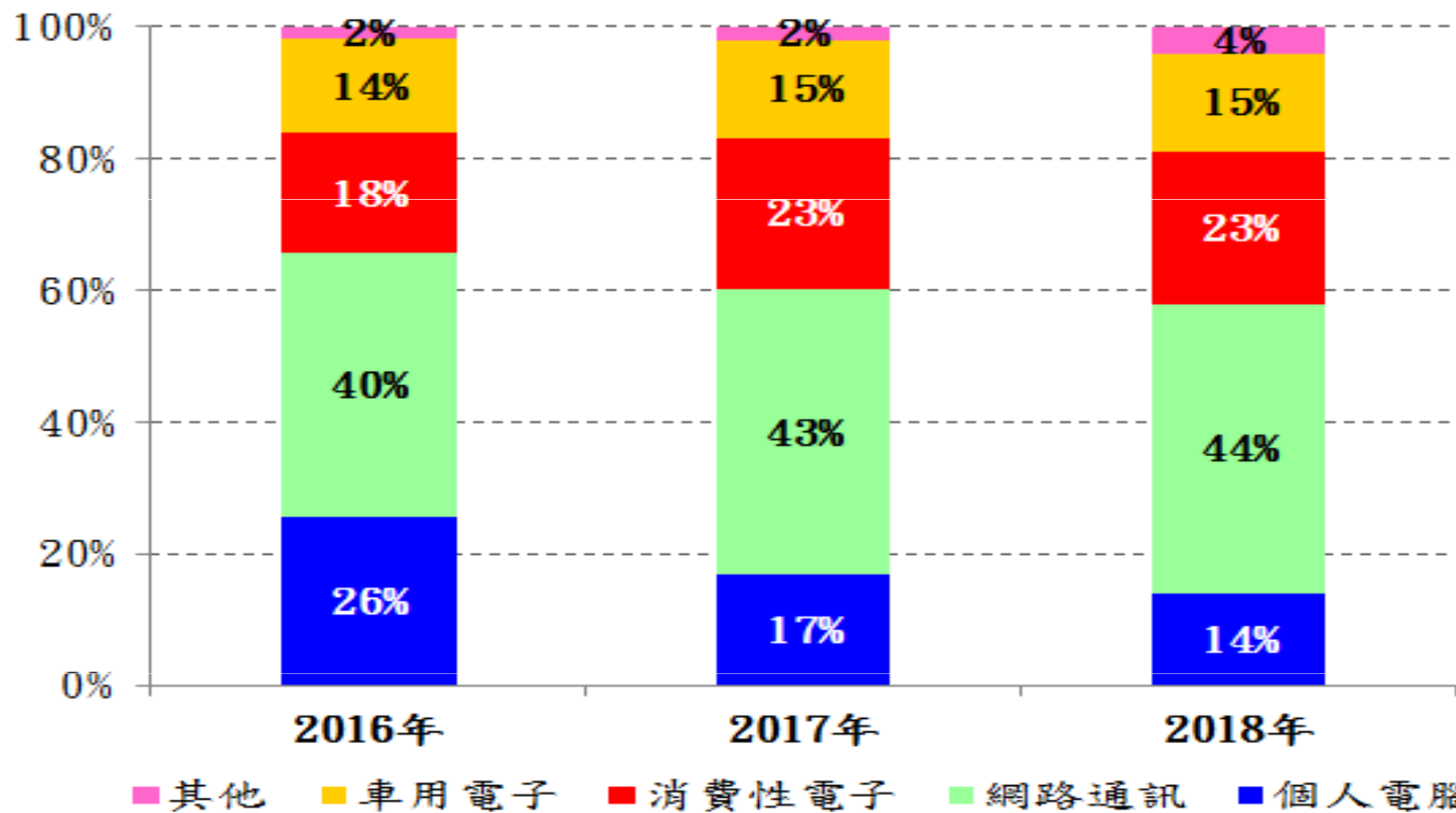


- 2018年第二季營業虧損較第一季減少32佰萬元：  
因客戶需求回溫，第二季產能利用率提高，故第二季虧損比第一季減少。
- 2018年第三季營業虧損較第二季減少469佰萬元：  
因高值化產品出貨量增加，且內部持續推動製程優化，提升生產效率與良率，致2018年第三季虧損比第二季大幅減少。
- 2018年第四季營業利益較第三季增加215佰萬元：  
因產品組合改善與新世代網通產品良率持續提升，故2018年第四季營業利益轉虧為盈。



# 財務狀況

## 營業收入結構(應用別)



- 受個人電腦應用產品銷售不佳與調整產品結構，使個人電腦應用產品佔營收比重逐年降低。
- 配合市場趨勢，本公司積極切入網路通訊設備、穿戴式裝置(消費性電子)及高效運算(其他)領域，故此三類應用產品佔營收比重逐年增加。



# 產品未來發展方向

## 持續拓展高值化產品

### ■ 5G網通設備

2019年將配合客戶，生產5G網通設備所需之電路板/IC載板，因其尺寸較大、層數較多、線路設計複雜、技術層次高，可有效提升產品平均售價。

### ■ SiP載板

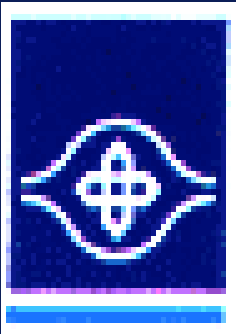
行動裝置、穿戴式裝置、網通設備將整合不同性質之晶片，封裝於同一載板上，以符合電子產品輕、薄、短、小之發展趨勢，系統級封裝載板需求可望再提升。

### ■ 車用電子

伴隨電動汽車與自動駕駛汽車持續發展，車用電路板的需求亦不斷增加，且因此類產品重視品質穩定性，故高階車用電路平均單價穩定。

### ■ 人工智慧/高效運算

因資料中心應用產品設計複雜，故須配合大尺寸、高層數及散熱佳之高階IC載板，在人工智慧與高效運算持續成長下，將帶動IC載板的需求量，且平均價格亦優於一般IC載板。



# 未來營運目標

## 公司追求營業利益轉虧為盈

### ■ 2018年第四季本業轉虧為盈

本公司致力於提升高值化產品出貨比重，改善產品組合，且因高層數、大尺寸載板生產良率持續提升，故2018年第四季營業利益轉虧為盈。

### ■ 2019年第一季進入傳統銷售淡季

受中美貿易摩擦與第一季傳統電子產品銷售淡季影響，營收表現將比去年第四季下滑；本公司已持續改善製程能力，以提升良率與效率，減緩淡季對公司營運之影響。

### 2019年追求全年營業利益轉虧為盈

**開源：**本公司在產品設計階段即與客戶緊密合作，以縮短學習曲線，今年將陸續推出人工智慧應用之高效能運算晶片載板、5G網通設備載板及7奈米繪圖晶片載板等；此外，亦開發新世代系統級封裝載板及車用主動安全系統電路板等，以有效提振業績。

**節流：**本公司將持續導入智能化生產以提升產品良率與生產效率，並透過各項成本控管改善專案，強化營運績效，今年將以全年營業利益轉虧為盈作為努力的目標。



感謝您的聆聽

